

各 位

会 社 名 宇部エクシモ株式会社
 本社所在地 東京都中央区日本橋富沢町9番19号
 問合せ先 総務部長 多田 厚美
 TEL 03-6667-2411

高純度単分散シリカ微粒子『ハイプレシカ®』大粒径タイプの量産化について

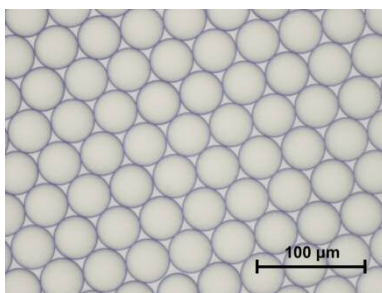
宇部エクシモ株式会社（社長：渡邊史信）は、高純度単分散シリカ微粒子（製品名：「ハイプレシカ®」）の大粒径タイプ（粒径 $13\mu\text{m}$ ～ $70\mu\text{m}$ ）の量産化に成功した。

「ハイプレシカ®」は、ゾルーゲル法を用いた独自の製法により、 $0.1\mu\text{m}$ （1万分の1mm）単位で高度に粒径が制御されたシリカ微粒子で、粒径精度が高く、粒度分布が非常にシャープで、不純物をほとんど含まず、極めて高純度である。さらに高温でも非常に安定しているという特長を持つ。現在、主に液晶ディスプレイ（LCD）パネルのギャップ制御用スペーサーとして、世界中で使用されているほか、タッチパネルや有機ELなどのスペーサーや電子材料用高機能充填材としても活用されている。

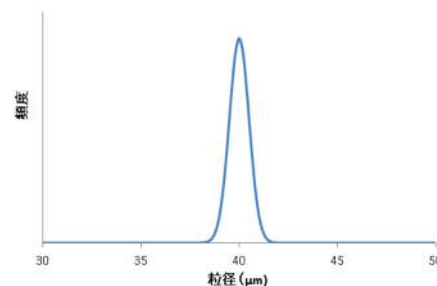
従来品のラインアップは、粒径 $0.2\mu\text{m}$ ～ $12\mu\text{m}$ であるが、今般、独自製法により $13\mu\text{m}$ ～ $70\mu\text{m}$ の大粒径タイプの量産が可能となった。 $13\mu\text{m}$ ～ $70\mu\text{m}$ サイズの高純度・単分散シリカ微粒子は他社では量産化されておらず、用途としては、光学デバイスの精密接着スペーサー（スマートフォン、車載カメラのレンズ部分の張り合わせ）や、MEMS（メムス、Micro Electro Mechanical Systems）の加速度センサー、高度計等への使用が見込まれており、今後更なる利用分野の拡大が期待されている。

大粒径タイプをラインアップに加えることにより、今年度の売上高は、従来品を含む「ハイプレシカ®」全体で2割増を目指す。

なお、宇部エクシモでは、 $1\mu\text{m}$ 以下の粒径で凝集のない小粒径タイプの量産化についても開発中で、今後主に半導体の封止材用充填材として展開していく計画である。



40 μm 品の光学顕微鏡像



平均粒径 40 μm の粒度分布(cv 値 1.25%) (モデル図)



用途例(イメージ図)